

BIO ICT DONATIONS PROGRAM

Bio ICT 捐款計畫

BioICT為推動電資通與生醫科技之研發創新、加值跨領域應用研究成果、有效促進國內產學研合作，並配合政府之連結未來、全球及在地三大產業發展策略，提升臺灣 Bio ICT 領域之國際競爭力，遂於2013年初成立BioICT聯盟，與認同BioICT之捐款企業、校友攜手合作，融合校園教學研發資源及產學合作典範移轉，從過去三年餘的計畫執行期間，許多新創團隊與企業校友咸認同BioICT聯盟的角色扮演與存在價值，並透過論壇/研討會以及各式活動進行產業技術交流媒合、趨勢分析以及人才培育等服務。

有鑑於近年來政府在政策上持續支持生醫產業的發展，並致力改善產業發展的環境，面對全球化的激烈競爭，臺灣必須以創新做為生醫產業發展的新動能，並將具有優勢的ICT產業運用到生醫領域上；最快最簡單的方法，就是把學術研究的創意、能量和成果，源源不絕轉化應用在產品端，本年度BioICT聯盟協同『經濟部生醫藥產業發展推動小組』共同策劃【半導體產業跨入體外生醫診斷醫療器材論壇】，於6月及9月共舉辦2場技術論壇，藉此讓在地的產學鏈結更形緊密，創造全新整合體系，提升產業輔導價值，增加異業合作商機。

為持續地、有效地轉化本校研究成果成為具有高商業價值的新創事業，並促進台灣企業技術深化與多元化發展、加速台灣產業結構升級、為社會創造就業機會、為國家培育人才，本年度擴充新創協成產業技術媒合服務於105年10月19日率先邀請美國應材(Applied Materials)進行生醫科技/先進材料產業媒合，並提供產學研技術合作、管理實務交流、成果分享及聯誼機會，以促進本校新創技術研發成果快速地導入商業化，並將於105年11月22日舉辦跨領域產官學研技術論壇，以跨領域創新技術論壇為交流平台，共同分享新創技術成果與啟發新思維，凝聚產學研的研發能量，擴大產業聚落效益，以提升產品的創新價值，期望未來在全球各產業領域獲得領先地位。



105年3月7日「台英生醫工程技術論壇」



產業技術媒合剪影



「Sentient Chip Workshop」活動側拍



「次世代生醫晶片基礎技術」活動側拍



105年10月19日美商應材產業技術媒合

BioICT 論壇年度活動列表

● 博愛技術論壇

論壇主題	專題演講
<p>「台英生醫工程技術論壇」 Bioengineering Technology Forum 地點：交大電資大樓國際會議廳 時間：105年3月7日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Novel Formats for In Vitro Diagnostics 新穎體外診斷技術 2. Noninvasive Wearable Medical Devices for Clinical Applications 非侵入式臨床應用之穿戴式感測裝置 3. Modelling and Optimising the Behaviour of Joint and Fracture Fixation Implants in Osteoporotic Bone 針對骨質疏鬆患者之骨折固定醫材之研究 4. Silicon Quantum Dot Nanoparticles with Antifouling Coatings for Immunostaining on Cancer Cells 應用於腫瘤細胞染色顯影之矽量子點奈米材料
<p>「台灣前瞻醫材技術論壇」技術論壇 地點：新竹生物醫學園區國際會議廳 時間：105年3月17日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. To innovate an achievable medical solution from a definite clinical demand 2. 穿戴式腦機系統研發與應用 3. 生命、生技、科技—國研院與台大醫院開發創新生技醫材之路 4. 人工水晶體及其植入系統 5. 微創脊椎醫療器材產品開發
<p>「Sentient Chip Workshop」技術論壇 地點：交大電資大樓國際會議廳 時間：105年6月2日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 感測元件與電路整合解決方案 2. CIC 感測電路系統整合驗證平台 3. 專題研討 (panel discussion)
<p>「次世代生醫晶片基礎技術」技術論壇 地點：交大電資大樓國際會議廳 時間：105年6月22日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 多功能生醫檢測晶片之系統整合 2. 精密塑膠射出應用於生醫晶片 3. 生醫檢測晶片系統整合技術 4. 智慧醫療 (Digital Health/mHealth) 市場趨勢
<p>「次世代生醫晶片基礎技術」技術論壇 地點：交大電資大樓國際會議廳 時間：105年9月14日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新創生醫產業與資本市場的互動 2. 以矽場效應電晶體作為即時高靈敏生醫分子檢測平台 3. 跨領域感測晶片應用於體外檢測醫療器材 4. 生技醫材半導體技術平台發展與營運模式

● 新華講堂跨領域創新課程

課程主題

1. 儲存器與儲存產品未來發展的趨勢與方向 / 群聯電子 林緯研發組長
2. Next Big Thing/ 台積電 劉信生處長
3. Circuits and Systems for Wireless Applications/ 交通大學 管延城教授
4. 談創新創業 -- 半導體的過去，現在，未來 / 聯電前董事長胡國強先生
5. Heterogeneous Integration Technology Roadmap X-on-Silicon/ 禾鈺股份有限公司 邵中和董事長
6. IC 設計產業發展趨勢與經驗分享 / 聯詠科技 丁振國副理